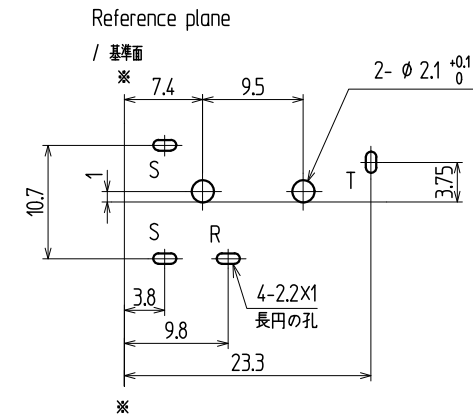
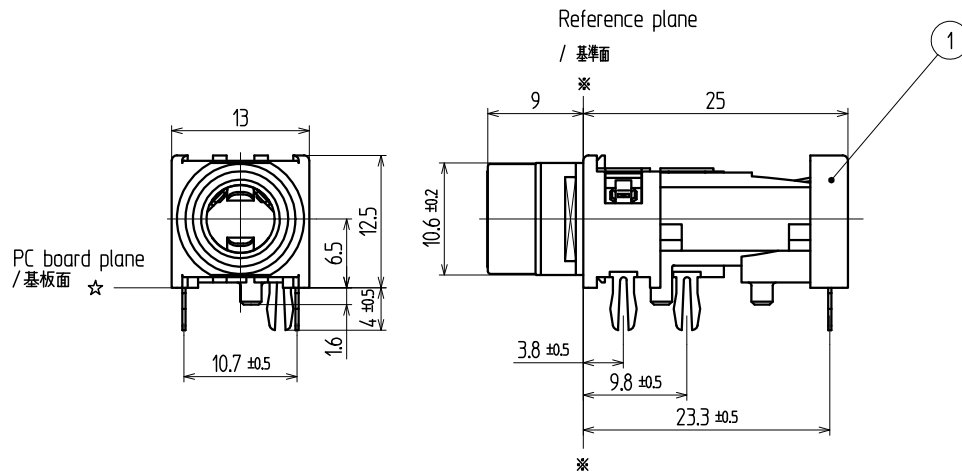
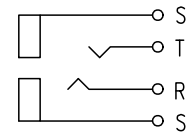


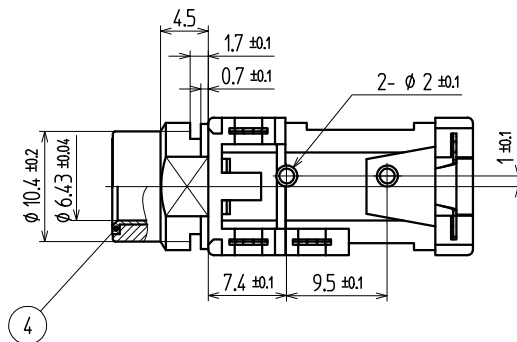
Detail of contact form / 端子形状詳細図 (S=5/1)



11.6 Dimensions of PC board holes / 参考基板孔 (Printed-side view / バターン側) (Tolerance / 公差 all \pm 0.1)



Circuit / 回路図



6.5 DIA PX3

No.	PARTS NAME	QTY	MATERIAL	No.	UL	FINISH	REMARKS
品番	名称	個数	材質			処理	備考
4	SLEEVE スリーブ	1	BRASS 黄銅 10.7				GOLD PLATED Au メッキ
3	TIP CONTACT チップパネ	1	PHOSPHOR BRONZE REFLOW TIN PLATED りん青銅 リフロースズメッキ材	10.3		(T)	
2	CONTACT コンタクト	3	PHOSPHOR BRONZE REFLOW TIN PLATED りん青銅 リフロースズメッキ材	10.3		(S , R)	
1	HOUSING ハウジング	1	耐熱ABS BLACK 黒			94HB	

ALL DIMENSIONS IN () ARE FOR REFERENCES ONLY () 印は、参考寸法				TITLE 6.5 DIA PHONE JACK / 大型単頭ジャック 名称		ISSUED 出 図	
APPROVED 責任者	CHECKED 検査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者	CODE No. YKB21-5317 コードNo.		DRAWING No. 図番	
				UNIT 単位 mm		PAGE ページ	
				SCALE 2/1 尺度		REVISION 版数	
				CUSTOMER CODE ユーザーコード			

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.

TOLERANCE 寸法公差			
under 未満 6	± 0.3	X	
over 以上 6	± 0.4	X	
under 未満 20	± 0.5	X	
over 以上 20	± 0.5	X	
ANGLE(DEG) 角 度	\pm	MARK 記号	

REVISIONS 改訂事項

DATE 日付

SIGN 担当